|  |
| --- |
| Test 환경 지원 신청서 |

* **신청팀 내역**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MPW 회차 | *예)MS180-1901회 매그나칩/SK하이닉스 180nm 공정* | | |
| Fab out 일 |  | | |
| 소속(대학명) |  | | |
| 지도교수 |  | **연락처 / e-mail** |  |
| 담당자 |  | **연락처 / e-mail** |  |

* **Test 환경 조사**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 제작 지원 내역 | *Package, CoB, PCB 중 선택하여 기재* | | |
| Fab제작 희망일 |  | **제작 희망일** |  |
| 제작 희망 업체 |  | 업체 정보 (연락처/e-mail) |  |

* **설계 개요**

칩내용 소개(설명은 10~15줄, 칩사진 및 설계 관련 사진 포함 - 1쪽이내)

설명글은 굴림체 폰트 10

* **Test 진행 방법**

제작된 환경을 활용하여 결과 도출을 위한 검증 방법에 대해 기재해 주십시오.

(내용과 제작 환경에 대한 도면 등 사진 포함 1쪽 이내로 작성 )

설명글은 굴림체 폰트 10

* **Test 결과 활용 계획**

Test 결과의 활용 계획을 기재(10줄 이내 작성)

설명글은 굴림체 폰트 10

**[첨부]제작 희망 type의 도면**

*제작 도면이 작성된 경우 이미지로 첨부 (1쪽이내) – 신청서 마지막 장 이용*